

2023年1月31日

各 位

会 社 名 富士通株式会社
代表者名 代表取締役社長 時田 隆仁
(コード番号 6702 東証プライム市場)
問合せ先 広報 IR 室長 野本 邦彦
(TEL. 03-6252-2175)

連結子会社（富士通セミコンダクター株式会社）との吸収合併（簡易吸収合併）契約締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年4月1日を効力発生日として、連結子会社である富士通セミコンダクター株式会社（以下、FSL）を吸収合併することを決議し、本日、合併契約をFSLとの間で締結いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当社とFSLとの間の合併は連結子会社を当事会社とする簡易吸収合併であるため、開示事項および開示内容を一部省略しています。

1. 本件合併の目的

当社は、経営方針に基づきコア事業であるテクノロジーソリューションへの経営資源の集中を進めており、目指すべき事業ポートフォリオに向けた取り組みとして、非注力領域のカーブアウトを行なっております。

そのような中、半導体事業についてはFSLを事業統括会社としたグループ構造を形成し、事業展開を行なってきましたが、2022年9月30日付でFSLの子会社である富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社の株式を譲渡したことにより、FSLグループにおける全ての事業のカーブアウトが完了しております。

今後の当社グループとしての経営効率化のため、FSLを2023年4月1日付で当社へ吸収合併いたします。

2. 本件合併の要旨

(1) 本件合併の日程

本件合併は、簡易吸収合併の要件を満たしているため、当社の株主総会決議を経ずに行います。

当社取締役会決議日 : 2023年1月31日（火）（本日）

本件合併契約締結日 : 2023年1月31日（火）（本日）

本件合併の効力発生日 : 2023年4月1日（土）（予定）

(2) 本件合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式でFSLは解散いたします。

(3) 本件合併に係る割当ての内容

本件合併による新株式の発行および合併交付金の支払はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

FSLは新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 本件合併の当事会社の概要

	存続会社		消滅会社
名称	富士通株式会社		富士通セミコンダクター株式会社
所在地	神奈川県川崎市		神奈川県横浜市
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 時田 隆仁		代表取締役社長 磯部 武司
事業内容	ソフトウェア・情報処理分野・通信分野の製品の開発・製造・販売ならびにサービスの提供		半導体にかかる FSL グループ会社の統括管理
資本金	324,625 百万円		100 百万円
設立年月日	1935 年 6 月 20 日		2014 年 9 月 1 日
発行済株式数	207,001 千株		400 千株
決算期	3 月		3 月
大株主および持株比率 (2022 年 9 月 30 日現在) ※持株比率は自己株式を除いて計算しております。	株主名	持株比率	富士通株式会社の完全子会社
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	17.40%	
	いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド	7.58%	
	株式会社日本カストディ銀行(信託口)	6.61%	
	GIC PRIVATE LIMITED - C	3.73%	
	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	1.94%	
直前事業年度の財政状態および経営成績 (2022 年 3 月 31 日現在)	〈連結決算〉 資本合計 1,715,749 百万円 資産合計 3,331,809 百万円 1 株当たり親会社所有者帰属持分 8,094.70 円 売上収益 3,586,839 百万円 営業利益 219,201 百万円 税引前利益 239,986 百万円 親会社の所有者に帰属する当期利益 182,691 百万円 基本的 1 株当たり当期利益 924.21 円 希薄化後 1 株当たり当期利益 922.97 円 ※当社の連結決算は、国際会計基準(IFRS)を適用しております		〈個別決算〉 純資産 18,976 百万円 総資産 19,970 百万円 1 株当たり純資産 47,441.94 円 売上高 597 百万円 営業利益 △174 百万円 経常利益 622 百万円 当期純利益 314 百万円 1 株当たり当期純利益 785.47 円

4. 本件合併後の状況

本件合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本件合併による連結業績への影響は軽微です。

以上